NS-TN4030
导热凝胶

泰亚电子科技
TAIYALUCK ELECTRONIC TECHNOLOGY



产品特点

- 无低分子量硅氧烷污染
- 单组分包装
- 使用时不需要混合或固化
- 低热阻、低压缩应力
- 具有高的粘性和可重工性能
- 高温下不流淌、不干涸

典型应用

- 汽车电子控制单元
- 内存和电源模块
- 微处理器散热
- 视觉控制系统
- 平板显示器
- 消费电子

产品规格

- 常规规格：10cc、50cc针筒注射器
- 可根据客户需求进行定制化

储存运输

- 常温下原包装储存，长时间不超过55℃以免影响储存时间
- 远离明火
- 按一般化学品搬运、运输本品为无毒非危险品

保质期

- 12个月

产品介绍

NS-TN4030是一种不含有机硅的导热凝胶，使用时不需要混合或固化，采用点胶的方式涂胶。NS-TN4030提供优异的导热性能和低的热阻，在非常低的压力下就可以达到高压缩率，从而减少器件上的应力。这种预固化的材料没有有机硅的污染或者泵出，与焊接化学品兼容，而且不影响组件表面重新涂漆的性能。

产品性能

基本性能	测试方法	典型值
产品	/	NS-TN4030
颜色	目测	蓝色/灰色
密度（g/cm^3）	ASTM D792	3.3±0.1
低分子量硅氧烷含量 D4~D10（ppm）	GC/MS	0
典型的最小界面厚度（um）	ASTM D5470	120
热阻（°C*cm^2/W）		0.18
导热系数（W/（m·K））		4.0
挤出速度（g/min）	30cc针筒，90psi	30
电气强度（kV/mm）	ASTM 149	≥6
体积电阻率（Ω·cm）	ASTM D257	10^{14}
介电常数（1MHz）	ASTM D150	6.0
阻燃等级	UL 94	V-0
工作温度范围（℃）	/	-55~150
ROHS Comliant	/	YES

注：以上数据为总体测试的平均值，可以联系我司提供更多的产品信息。

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用泰亚硅胶泡棉材料进行的设计，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用，或者是不同条件和环境下的使用，产生的结果泰亚将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定泰亚硅胶泡棉材料的适用性。

发布日期：2025-06-12